

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

深圳市江波龍電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09976)

海外監管公告 投資者關係活動記錄表

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列深圳市江波龍電子股份有限公司(「**本公司**」)於2026年9月22日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《2026年9月17日-21日投資者關係活動記錄表》，僅供參閱。

承董事會命

深圳市江波龍電子股份有限公司

董事長

蔡華波先生

深圳，2026年9月22日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事蔡華波先生、李志雄先生及王景陽先生；及(ii)非執行董事蔡靖先生及胡穎平先生；及(iii)獨立非執行董事唐忠誠先生、陳偉岳先生、黃志強先生及鄧美珊女士。

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 电话会议 □ 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、方正富邦、东方阿尔法、国寿资产、易方达、德邦基金
时间	2026 年 9 月 17 日(周四) 10:00-11:00 2026 年 9 月 17 日(周四) 15:30-16:30 2026 年 9 月 18 日(周五) 10:00-11:00 2026 年 9 月 21 日(周一) 9:40-10:40 2026 年 9 月 21 日(周一) 15:00-16:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦

投资者关系活动 主要内容介绍	1、存储价格上涨，存货当中的低价晶圆大量消耗后，公司盈利能力将如何变化？ 答：公司采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本，存储晶圆价格上涨的影响已动态反映在实际营业成本中。与此同时，存储价格增长反映的是行业供需关系及产业景气度改善，而非单一的成本变动。 从存储器行业的历史经营情况看，企业的长期盈利能力既取决于技术实力、产业链协同能力等综合竞争优势，也与高端客户占比密切相关。具备领先技术能力、多元化产品矩阵及完善产业链布局的企业，能够更好满足大客户对产品性能、兼容适配、可靠性及稳定供货等方面的综合要求，从而持续提升高端客户占比。通常而言，高端客户占比较高的企业，具有更强的盈利能力和相对明显的弱周期特征。 在 AI 发展浪潮下，公司坚定执行全面拥抱端侧 AI 的发展战略，前期重点投入的主控芯片、企业级存储、mSSD 等产品已陆续取得实质性商业进展，并持续深化与全球知名客户的合作和导入，不断提升高端客户收入占比，为公司业务增长及盈利能力提升提供支撑。近期，公司还推出了 HLC（高级缓存技术）、AIDIMM、AILPGBA 等全面适配端侧 AI 的新技术、新产品。随着相关产品逐步导入市场并实现更广泛的规模化应用，公司高端、高壁垒、高附加值产品的收入占比有望进一步提升，持续优化产品结构和盈利结构。 2、HLC 技术是如何实现存储的更高效利用的？HLC 技术的研发与商业化进展情况如何？如何看待 HLC 技术的市场空间？ 答：HLC 技术基于公司自研高性能主控芯片、专属固件与系统级架构的协同配合，让 SSD 或 UFS 存储设备承接
---------------------------	---

	原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，将高度依赖 DRAM 的缓存负载精准卸载至 NAND 中，在维持系统性能的前提下，能够有效降低终端设备的 DRAM 配置要求。 公司已与 AMD、紫光展锐、全球 SoC 头部企业、全球 CPU 头部企业等多家主芯片厂商开展 HLC 相关技术的适配工作。其中，基于与 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，相比传统存储方案，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%。 目前，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。HLC 技术与配套产品生态，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。 3、如何看待 AIDIMM 的应用前景？ 答：公司发布的 AIDIMM，作为针对 AI 计算深度优化的内存，最高容量达 128GB，带宽最高达到 307.2GB/s，根据公开资料，HBM2 容量为 8GB，理论峰值带宽为 256-307GB/s，AIDIMM 的容量、带宽等关键指标也远优于 UDIMM、SODIMM 等传统内存产品。 AIDIMM 产品采用 4 颗 LPDDR5x 同面布局设计，可适配主流智能体主机的主板架构，无需对现有硬件进行大幅改造。AIDIMM 能有效解决当前智能体主机普遍存在的内存容量不足、算力任务卡顿等核心难题，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，更好释放终端 AI 算力。 4、如何看待存储价格未来变化趋势？ 答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 在云端和端
--	---

	侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的 NAND 资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的 NAND 供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无